

エレクトロニクス機器における熱設計技術

目 次

総論	3
	東京工科大学 小木 曾 建
第1編 基礎と要素技術	
第1章 熱設計の基礎	19
	九州大学 藤 井 丕 夫
	九州工業大学 増 岡 隆 士
第2章 冷却法	59
	株式会社 東芝 石 塚 勝
第3章 放熱設計のアプローチ	91
	三菱電機株式会社 大 串 哲 朗
	高 田 潤 二
第4章 シミュレーション技術	137
	株式会社 東芝 横 野 泰 之
第5章 熱対策技術	171
	株式会社 東芝 横 野 泰 之
第6章 熱設計評価技術	217
	株式会社 東芝 横 野 泰 之
第2編 応用と事例	
第1章 ICチップの熱保証と事例	251
	日本電信電話株式会社 海 津 勝 美

第2章	パッケージの熱設計と事例	269
	シャープ株式会社 中西 宏之 曾田 義樹	
第3章	プリント基板における熱設計と事例	
第1項	富士通株式会社編	291
	富士通株式会社 川島 寿	
第2項	株式会社シイエムケイ回路設計センター編	317
	株式会社 シイエムケイ回路設計センター 諸橋 欣一	
第4章	筐体の熱設計と事例	335
	日本電信電話株式会社 岸本 亨	
第5章	装置・システムの熱設計と事例	363
	松下冷機株式会社 川村 隆男	
第3編	先端冷却技術	
第1章	ヒートパイプ	395
	古河電気工業株式会社 村瀬 孝志	
第2章	マルチチップモジュール	415
	株式会社 日立製作所 高橋 研二	
第3章	ピンフィン	439
	株式会社 東芝 水上 浩 東京農工大学 望月 貞成	
第4章	マイクロチャネル冷却	487
	日本電信電話株式会社 岸本 亨	
第5章	高伝導冷却	
第1項	TFラバー	505
	三菱電機株式会社 大串 哲朗	

第2項 セラミックス	517
	株式会社 東芝 岩瀬 暢 男
	浅井 博 紀
第6章 小型高性能ファン	543
	日本サーボ株式会社 島崎 伊智朗
第7章 ペルチエ効果	569
	工業技術院 電子技術総合研究所 太田 敏 隆